# 作品名称

姓名1；姓名2

**第一部分 设计概述**

* 1. 设计目的

200字内

* 1. 应用领域

200字内

* 1. 主要技术特点

300字内

* 1. 关键性能指标

300字内

**第二部分 系统组成及功能说明**

* 1. 整体介绍

给出芯片或系统整体框图，各子模块标注清楚，并进行整体的文字说明，需要表达出各模块之间的关系。

* 1. 各模块介绍

根据总体系统框图，给出各模块的具体设计说明。

**第三部分 完成情况及性能参数**

具体完成的情况，可图文结合，具体的性能参数等量化指标

**第四部分 总结**

* 1. 主要创新点

按照（1）、（2）……列出

* 1. 可扩展之处
  2. 心得体会

**第五部分 参考文献**

**第六部分 附录**

重要代码、推导过程等不便于在正文中体现的内容